

证券代码：003043

证券简称：华亚智能

苏州华亚智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：投 2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
时间	2024年5月16日 15:30-16:30
参与单位及人员	线上参与公司2023年年度及2024年第一季度业绩说明会的全体投资者
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 王彩男 董事兼财务负责人 钱亚萍 独立董事 包海山 副总经理兼董事会秘书 杨曙光 东吴证券保荐代表人 陈辛慈 东吴证券保荐代表人 潘哲盛
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司在新能源领域中有哪一些产品？ 回复：公司在新能源领域的结构件主要应用在工业储能、商业储能和家用储能设备上，也有光伏逆变器、充电桩等。 谢谢！ 2、请问董事长，在全球经济下行的情况下，公司有什么核心竞争力去提高公司的经营情况？ 回复：公司竞争力主要体现在定制化的全流程大型生产规模优势，柔性生产能力，拥有较多自主研发的加工技术优势、集成化的系统管理运营能力、稳定的客户资源优势等，这样保证了公司的经营优势、交付产品能力，有效满足客户需求。

3、你好，请问你们公司跟华为有合作吗？此外，之前审批的几十亩地以及相应的规划建厂，进度如何？新建厂的产能主要供给国内还是国外？

回复：您好！公司新建的项目目前已完成竣工验收，目前处于使用的前期阶段。公司新建厂的产能主要供给国内市场，先后满足在半导体和新能源领域更多客户的需求。在巩固现有国外半导体领域客户需求的同时，积极开拓新的国外客户及产品，进一步提升公司经营规模。谢谢！

4、请问公司 2024 年的发展计划是什么？

回复：您好，2024 年，公司再融资项目的新建厂房和 IPO 扩建项目以及研发中心将先后竣工并陆续投用，这为公司实现新的战略规划及高质量发展奠定了良好的基础。在扩充产能的同时，我们也在积极开发国内外客户需求，大力推进半导体业务、新能源及电力等其他业务增长，捕捉行业发展机遇，拓宽产品应用领域；另一方面，进一步重点建设半导体、医疗器械等领域的集成装配业务。公司将整体加快实现智能化、信息化、数字化专业生产。谢谢！

5、请问公司 24 年一季度半导体业务同比 23 年一季度和环比 23 年第四季度有怎样的变化？

回复：公司 2024 年第一季度半导体业务同比 2023 年第一季度和环比 2023 年第四季度均有较大幅度提升。

6、希望董事会能关心下市值管理，提升公司的股票价值！

回复：您好，股价受宏观经济、市场环境、投资者预期等多重因素影响。我们始终相信，产品、技术、客户是企业立足于市场的根本，企业的市值是建立在产品和市场之上的。公司一直把拓展高端领域的市场和生产高精度的产品，满足客户需求作为公司核心的发展业务。未来，公司将加继续大力度，采取包括优化和扩展产品结构等在内的多种措施提升公司的经营规模和盈利能力，同时积极向市

场传递公司的优势和价值，以良好的业绩回馈社会和广大投资者的关注与支持！谢谢！

7、请介绍公司收购苏州冠鸿智能装备有限公司可能带来的协同效应有哪些？

回复：您好！首先，上市公司长期深耕半导体设备领域，通过此次并购将有效融合标的公司在智能装备系统领域产品、技术、人才等方面的优势，实现生产辅助智能装备系统在半导体设备制造领域的应用和拓展，提升半导体设备国产化的智能化水平。其次，上市公司将结合标的公司在动力和储能电池等领域积累的客户资源，实现精密金属制造在前述应用领域的延伸，借助行业的发展契机提升上市公司业务规模。最后，上市公司已成立了自动化装配事业部，提高半导体设备等专业领域的集成装配能力，加大在集成装配业务的投入，重点支持和满足国内半导体设备厂商的需求。本次交易后，上市公司将通过融合标的公司在集成方面的技术优势，提升自身集成装配能力，推动上市公司从精密金属制造商向具备集成能力的综合配套制造服务商转型。谢谢！

8、公司的主营业务半导体设备所处的行业发展情况如何？

回复：您好！半导体设备是半导体芯片生产过程中的关键工具，用于制造、测试和包装半导体芯片。其中，生产半导体的核心专用设备是半导体产业的技术先导者，芯片设计、晶圆制造和封装测试等需在设备技术允许的范围内设计和制造，设备的技术进步又反过来推动半导体行业零件市场依然具备较好的发展前景。随着物联网、人工智能、5G 通信、汽车电子等新型应用市场的快速发展，对半导体的需求将持续增长，从而带动半导体设备行业的繁荣。根据 SEMI 统计数据，2024 年世界半导体设备市场预计增

长 4.4%，达到 1053 亿美元；2025 年预计将回升到 1241 亿美元，增长 17.9%。感谢您的关注！

9、请问公司 23 年和 24 年一季度出口额和国内销售额占比情况怎样？

回复：公司 2023 年国内销售额占比高于出口销售额占比，2024 年第一季度国内销售额占比与出口额占比相差不大。谢谢！

10、请问马来西亚子公司生产情况未达预期的主要原因是什么，目前建设生产情况如何？

回复：您好！马来西亚子公司生产未达预期的主要原因是受国外供应链大环境的影响和属地的人才供给的影响。目前马来西亚子公司的经营处于小批量生产和部分新品研发阶段。谢谢！

11、请问董事长，贵公司是否有股权激励计划？行业市场波动，股价波动，公司有无采取什么措施？

回复：您好，公司 2024 年 3 月推出股权激励计划，后续若有新的进展，公司将及时进行披露。公司将继续努力做好经营生产，切切实实的做好业绩，提高公司盈利能力，提高治理水平，提升公司的内在价值。谢谢！

12、请问杨总，公司的业务模式是怎样的呢？

回复：您好！公司的业务模式为定制化的供应链合约制造业务模式，即通过供应商资格认证等程序进入客户供应链系统，之后根据客户的订单需求进行产品认证、生产和销售。谢谢！

13、请问公司的生产模式是怎样的？

回复：您好！公司实行以销定产为主的生产模式，以自主生产为主。公司生产的精密金属结构件为定制化产品，产品所使用的原材料类型、工艺流程、生产周期均有差异。公司针对每款产品制定相应的作业指导书，通过智能化管

理方式直接有效控制生产工艺的稳定，将操作风险降到最低，保证生产时产品的质量、稳定性及成品率，有效控制成本。谢谢！

14、请问公司半导体业务中是否有除了刻蚀机、薄膜沉积设备外，还有其他的应用吗？

回复：您好！公司的高精密结构件在半导体领域，除了应用在刻蚀机、薄膜沉积设备上外，还有应用在印刷设备、涂胶和显影和光刻机等设备上。谢谢！

15、请介绍公司计划发行股份收购苏州冠鸿智能装备有限公司的最新进度如何？

回复：您好！因标的公司财报有效期到期，目前在更新年报，后续进展见公司公告。谢谢！

16、请问公司目前所处的行业发展前景如何？目前公司在国内处在一个什么样的排名上？

回复：您好，全球半导体市场规模的不断扩大将推动半导体设备市场的增长。随着人工智能、物联网、通信、汽车电子等新型应用市场的快速发展，对半导体的需求将持续增长，从而推动半导体设备行业不断创新和进步，带动半导体设备行业的繁荣。配电设备是构成输配电系统的主体，配电设备行业对国民经济影响较大。展望未来，光伏、储能、智能电网、分布式能源、电动汽车等行业快速发展，储能行业有望迎来历史性发展机遇。公司是国内为数不多的集结构件制造、机加工、焊接、表面处理、集成装配和部件维修的大规模综合服务商。

17、请问两位保代，公司面临的发展风险有哪些？

回复：您好，公司面临的发展风险主要包括几个方面：下游行业波动、上游大宗商品原材料价格波动、毛利率波动甚至下降的风险。此外，募集资金投资项目及效益方面也存在一定风险。

	<p>18、公司募投项目进度如何？年内是否可以投出？</p> <p>回复：您好，公司 IPO 募投项目预计可使用时间为 2024 年 6 月 30 日。</p> <p>19、请问公司的销售模式是怎样的？</p> <p>回复：您好！目前，公司大部分客户均为常年合作的优质客户，由于产品均为定制产品，公司在接收订单的同时会与客户就产品设计方案、交付时间、数量、交付地点等要素进行确认，明确交易条款或交付方式。报告期内，公司的业务模式未发生重大变化。谢谢！</p> <p>20、请问包总，公司在行业内的市场地位又是怎样的？</p> <p>回复：您好，公司拥有从精密数控技术、精密金属焊接技术、塑焊技术、精密金加工技术、表面处理技术到精密装配技术、精密设备部件维修技术的完整的生产线；拥有众多核心专利技术和独有的生产技术，是国内为数不多的集精密金属结构件制造、设备装配及维修服务为一体的综合配套制造大规模服务商。同时，公司还拥有严格的质量控制体系和严苛的品质管控措施，建立了完善的质量控制制度，使得公司产品能够满足半导体设备等技术要求较高的行业要求，获得各业务领域内客户的认可，与众多国内外品牌客户建立长期稳定的合作关系。谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 16 日